

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他（ ）
参与单位名称	<u>2025 年 2 月 26 日</u> 前海开源基金、信达澳亚基金、中欧基金、平安养老保险、万方资产、南方基金、国新投资、北汽产业投资等 <u>2025 年 2 月 27 日</u> 鹏华基金、善达投资、岭创投资、中保投资、深圳亿鑫投资、长城基金、宝盈基金、博时基金等 <u>2025 年 2 月 28 日</u> 广汽资本、上海顶天投资、广发资管、广州白云金控、广州工控资本、广晟集团、国泰租赁、广州城发基金、易方达基金等
时间	2025 年 2 月 26 日、2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 日
调研方式	线下会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）

投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。 公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processor IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。 基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。 为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。 基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。 芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nmFinFET 和 28nm/22nmFD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企

	业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。 2020 年至 2022 年，公司营业收入复合增长率约为 33%。2021 年，在行业产能紧张的情况下，公司实现量产业务收入同比增长约 35%，营业收入同比增长约 42%，实现净利润扭亏为盈。2022 年，全球半导体产业下行，公司营业收入逆势增长约 25%，净利润与扣非后净利润均实现盈利，成功实现了“摘 U”。2023 年，在产业环境非常艰难的情况下，公司仍然保持了上半年净利润、扣非后净利润均为正。受全球经济增速放缓，半导体行业周期下行以及去库存的影响，公司仅三个季度收入同比下滑。2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，公司自二季度起，经营情况快速扭转。公司 2024 年第二季度营业收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024 年第三季度营业收入创历年三季度收入新高，同比增长 23.60%，根据公司《2024 年年度业绩快报公告》，公司预计第四季度收入同比增长超 17%，全年营业收入预计基本与 2023 年持平。2024 年下半年，公司芯片设计业务收入同比增长约 81%，知识产权授权使用费业务收入同比增长约 21%，量产业务收入同比下降约 4%。2024 年第四季度，公司芯片设计业务收入同比增长约 81%，知识产权授权使用费业务收入同比下降约 28%，量产业务收入同比增长约 32%，体现了公司收入受行业下行周期影响较晚、恢复增长较早的特点。 经过 20 多年的持续高研发投入，公司已经拥有丰富且优质的技术储备，并在别的公司不招人、少招人的产业下行周期，芯原逆向思维，在 2024 届校招中近 1 万人进行了全球统一在线笔试，约 1,800 人进入面试环节，我们录取了 200 多名应届毕业生，其中，硕士 985、211 的占比为 97%，其中本硕都是 985、211 的占比 85%。 公司潜心投入关键应用领域技术研发，如五年前开始布局 Chiplet 技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用。公司在三年前就开始研发超轻量、超低功耗的 AI/AR 眼镜芯片设计平台，为全球知名的互联网企业定制了 AR 眼镜专用芯片，还与其始终在线的开源项目展开深度
--	---

	合作，形成了完整的技术平台。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。
交流问答	问题：请问公司目前在手订单情况如何？ 回复：根据公司《2024 年年度业绩快报公告》，截至 2024 年末，公司订单情况良好，在手订单 24.06 亿元，较三季度末的 21.38 亿元进一步提升近 13%，在手订单已连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024 年四季度公司新签订单超 9.4 亿元，2024 年下半年新签订单总额较 2024 年上半年提升超 38%，较 2023 年下半年同比提升超 36%，较半导体行业周期下行及去库存影响下的 2023 年上半年大幅提升超 66%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。 问题：请问公司在视频编解码领域的客户情况如何？ 回复：互联网视频相关应用市场日益增长，如 4K 高清直播、在线会议、云游戏等应用，都需要在数据中心进行高密集度的视频解码和编码。芯原的数据中心视频转码平台可以大幅度提高数据中心的视频处理能力，并降低整体功耗和成本。芯原的视频处理器 IP 系列中最新一代的 VC9800 系列 IP 具备高性能、高吞吐量和服务器级别的多码流编解码能力，可支持最高 256 路码流，并兼容所有的主流视频格式，包括新一代先进格式 VVC 等，可满足包括视频转码服务器、AI 服务器、云桌面和云游戏等在内的下一代数据中心的先进需求。目前，视频处理器 IP 技术已经获得多家客户的认可，其中包括中国前 5 名互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 名云服务提供商中的 12 家客户。 此外，芯原数据中心视频转码加速解决方案可以为客户提供基于芯原自有 IP 的高性能视频转码芯片和开源软件一体化解决方案，广泛应用于视频加速卡、流媒体及视频点播、数据中心服务器及安全监控视频系统

	等，为客户提供高性能视频处理的同时，极大地降低整体功耗和成本。目前，公司视频转码平台项目进展顺利，第一代平台已于 2021 年第二季度完成研发工作，并以 IP 授权、一站式芯片定制业务等方式获得了多家客户的采用，已完成适配并陆续出货；基于芯原 IP 的第二代视频转码平台一站式芯片定制项目（包括软硬件协同验证）已基本完成，该平台在原有的技术基础上将不同格式视频转码能力增强到 8K，增加了对 AV1 格式的支持，并新增了 AI 处理能力，此外，还增加了高性能的多核 RISC-V CPU 和硬件的加密引擎。 问题：按照公司下游客户行业来看，公司来自哪些领域的收入增速较快？ 回复：公司不断开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，受下游市场需求带动，2024 年前三季度，公司来自数据处理、汽车电子和计算机及周边领域的收入分别同比增长 72.61%、50.19%和 42.86%，上述领域收入占营业收入比重分别提升至 22.78%、10.43%和 14.27%。 问题：请问公司在 AR 眼镜领域有哪些布局？ 回复：随着人工智能语音、视觉技术，以及低功耗数据处理技术的快速发展，以 AR 眼镜为代表的智慧可穿戴设备可搭载更为自然的人机交互界面和越来越强大的本地 AI 处理能力，创新人们的数字生活和社交。公司积极布局。公司积极布局 AR/VR 眼镜等增量市场，拥有面向 AR/VR 领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以帮助客户打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量实时在线、低功耗以及全性能的全场景应用。目前，公司已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，此外还有数家全球领先的 AR/VR 客户正在与芯原进行合作。
--	--

问题：请问公司对于未来 IP 研发的规划是怎样的？

回复：通过多年的技术研发积累，芯原目前已拥有六大处理器 IP、1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP，IP 齐备程度很高，各 IP 的市场竞争力也非常强。随着市场和行业的发展，我们原有的 IP 会持续根据客户和市场需求迭代，在此基础上，我们也会根据技术和市场发展趋势，结合公司自身的优势，有计划地丰富公司的 IP 版图，多个 IP 行成“组合拳”来更好地满足不同场景下的客户需求。

目前，我们已推出了基于半导体 IP 的平台授权业务模式，这种授权平台通常含有公司的多个 IP 产品，例如芯原的 NPU IP 可以结合芯原其他处理器 IP，支持多种应用场景的人工智能升级发展，目前，我们的 AI-ISP 系列已经广泛获得了手机、机器视觉相关应用客户的青睐。类似的 AI-Video 技术、AI 和 GPGPU 的结合等等，都已有相关行业龙头客户采用。

问题：请问公司在 Chiplet 领域有哪些技术储备和项目经验？

回复：随着各行各业进入人工智能升级的关键时期，市场对于大算力的需求急剧增长。在此背景下，集成电路行业正经历从 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）的转型，这一转变是出于对高性能单芯片集成度与复杂性的提升、性能与功耗的优化、良率与设计/制造成本改善等多方面的考量。为了适应这一发展趋势，芯原正在将其在 SoC 中扮演重要角色的半导体 IP（知识产权）升级为 SiP 中的核心组件——Chiplet，并基于此构建 Chiplet 架构的芯片设计服务平台。

目前，公司 Chiplet 业务进展顺利，芯原已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的高端应用处理器，采用了 MCM 先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的高算力 AIGC 芯片设计了 2.5DCoWos 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCle/BoW 兼容的物理层接口；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者蓝洋智能合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基

	于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。 公司再融资募投项目之一为“AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目”，并形成基于 Chiplet 架构的软硬件芯片设计平台，对公司现有技术有如下提升：1) 结合公司 IP 技术、芯片软硬件设计能力等，新增高算力 GPGPU Chiplet、AI Chiplet 和主控 Chiplet；2) 新增 Die to Die 接口 IP 及相关软件协议栈；3) 强化先进封装技术的设计与应用能力；4) 开发基于 Chiplet 架构的可扩展大算力软硬件架构。 问题：请问公司是如何保持较低的员工主动离职率？ 回复：公司坚信人才是公司发展的关键资源之一，在企业管理上，公司奉行用人文精神和人文关怀引导公司发展，倡导“公正、关爱、分享与快乐”的企业文化，在内部人才培养方面，公司不断实行完善有效的培养方案和公开透明的晋升机制，包括通过线上线下的技术和管理培训，提高员工的综合发展能力；积极营造良好的工作环境，从企业文化、薪酬福利、人才激励等方面提高员工的凝聚力等。在 2024 年上半年，公司人才稳定性保持于较高水平，中国大陆地区员工主动离职率为 1.42%，远低于中国大陆半导体行业平均约 6.9%的主动离职率。
--	--